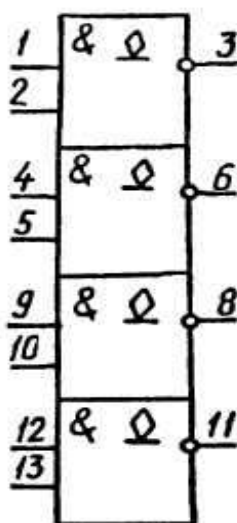


# КР1533ЛА9, КФ1533ЛА9, ЭКА1533ЛА9, ЭКФ1533ЛА9

Микросхемы представляют собой четыре логических элемента 2И-НЕ с открытым коллекторным выходом. Содержат 64 интегральных элемента. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г и 4306.14-А.

Назначение выводов: 1 - вход информационный D1.1; 2 - вход информационный D1.2; 3 - выход  $\overline{Y1}$ ; 4 - вход информационный D2.1; 5 - вход информационный D2.2; 6 - выход  $\overline{Y2}$ ; 7 - общий; 8 - выход  $\overline{Y3}$ ; 9 - вход информационный D3.1; 10 - вход информационный D3.2; 11 - выход  $\overline{Y4}$ ; 12 - вход информационный D4.1; 13 - вход информационный D4.2; 14 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР1533ЛА9, КФ1533ЛА9, ЭКА1533ЛА9, ЭКФ1533ЛА9

## Электрические параметры

Номинальное напряжение питания .....	5 В ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня:	
- при $I_{\text{вых}}^0 = 4 \text{ мА}$ .....	≤ 0,4 В
- при $I_{\text{вых}}^0 = 8 \text{ мА}$ .....	≤ 0,5 В
Выходное напряжение высокого уровня .....	≥ 2,5 В
Прямое падение напряжения на антизвонном диоде .....	≤  -1,5  В
Ток потребления при низком уровне выходного напряжения при $U_{\text{п}} = 5,5 \text{ В}$ .....	≤ 3 мА
Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения при $U_{\text{п}} = 5,5 \text{ В}$ .....	≤ 0,85 мА
Входной ток низкого уровня .....	≤  -0,1  мА
Входной ток высокого уровня .....	≤ 20 мкА

Входной пробивной ток .....	$\leq 0,1$ мА
Выходной ток высокого уровня .....	$\leq 100$ мкА
Время задержки распространения сигнала при включении .....	$\leq 22$ нс
Время задержки распространения сигнала при выключении .....	$\leq 54$ нс
Емкость входа .....	$\leq 5$ пФ
Емкость выхода .....	$\leq 7$ пФ

### **Предельно допустимые режимы эксплуатации**

Напряжение питания .....	4,5...5,5 В
Входное напряжение низкого уровня .....	0...0,8 В
Входное напряжение высокого уровня .....	2...5,5 В
Максимальное напряжение, подаваемое на выход .....	5,5 В
Температура окружающей среды .....	-10...+70 °С

### **Общие рекомендации по применению**

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °С; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °С; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °С; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не

более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °С.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака  $65 \pm 5$  °С.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения  $5 \text{ В} \pm 10\%$ , к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.